

99-2 Preliminary Syllabus, Da-Yeh Univ

Information			
Title	電子封裝概論	Serial No. / ID	1869 / MAV4020
Dept.	機械與自動化工程學系	School System / Class	四技部4年1班
Lecturer	鄭江河	Full or Part-time	專任
Required / Credit	Optinal / 3	Graduate Class	Yes
Time / Place	(二)56 / H466 (三)9 / H466	Language	Chinese

Introduction	
電子封裝是半導體製造產業之後段製程，在本課程除教授傳統的塑膠構裝、陶瓷構裝、捲帶自動接合外，也介紹目前新型構裝技術，如覆晶、球陣列式構裝、晶片形構裝及異方性導電膠。	

Outline	
1 前言	
2 聯線技術	
3 塑膠構裝	
4 陶瓷構裝	
5 薄/厚膜技術	
6 捲帶自動接合	
7 覆晶接合	
8 異方性導電膠	
9 新型構裝技術	

Prerequisite	
半導體製程、微機電系統概論	